

Pressemitteilung

26. Juli 2006

Umicore investiert in koreanischen Elektronikmaterialhersteller

Umicore hat heute an der Börse Seoul eine Vereinbarung über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft Duksan Hi-Metal Co. Ltd. (Duksan) unterzeichnet. Duksan ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Ulsan, Südkorea, das sich auf die Herstellung von Materialien für elektronische Verpackungsanwendungen spezialisiert hat.

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Umicore eine Beteiligung von 14 % an Duksan. Die von Duksan gefertigten Lotkugeln für Ball Grid Arrays (BGA) sollen weltweit über das Umicore Vertriebsnetz vertrieben werden. Umicore und Duksan werden auch in den Bereichen Forschung und Entwicklung, in der Produktion von BGA-Kugeln und Lotpasten für BGA-Pakete mit verringertem Löt punktabstand für den Einsatz in elektronischen Verpackungsanwendungen zusammenarbeiten.

Über diese Investition in Höhe von rund 13 Millionen € wird die Geschäftseinheit Electronic Packaging Materials von Umicore (Teil des Geschäftsbereichs Technical Materials) in der Lage sein, die eigene Position am Weltmarkt zu verstärken und den rasant wachsenden Elektronikmarkt in Asien besser zu bedienen. Am Markt für BGA wird ein starkes Wachstum prognostiziert, da immer modernere Verpackungstechnologien Einzug halten und hierfür schnellere und leistungsstärkere integrierte elektronische Schaltungen benötigt werden. Außerdem wird davon ausgegangen, dass der Markt von der kontinuierlichen Nachfragesteigerung nach tragbaren elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, PDA und Digitalkameras profitieren wird.

Die Investition soll mit sofortiger Wirkung ertragswirksam sein.

Umicore AG & Co. KG Kommunikation

Rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau-Wolfgang
www.umicore.de

Telefon +49 6181 59 02
Fax +49 6181 59 4356
e-mail info@eu.umicore.com

Umsatzsteuer Ident-Nr. DE813 201 955
BLZ 500 107 00, Konto 560 169, SWIFT DEGU DE FF

Nähere Informationen:

Chips sind empfindlich und müssen so *umhüllt* werden, dass sie vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Gleichzeitig können diese als Gehäuse dienenden Materialien jedoch dazu benutzt werden, um die Chips mit einer größeren Zahl von elektronischen Verbindungen auszustatten und somit der Forderung nach Bündelung von mehr Leistung auf kleinerer Fläche zu genügen. Beim Ball Grid Array (BGA) dienen kleine Lotperlen, die kompakt nebeneinander in einem Raster angeordnet sind, als externe Anschlüsse: Die BGA-Technik hat für einen Durchbruch bei der Miniaturisierung von Elektronikwaren gesorgt, denn sie ermöglicht aufgrund der zweidimensionalen Verteilung der elektrischen Kontakte integrierte, kompakt angeordnete Schaltungen. Die Lotperlen, die für die BGA-Technik verwendet werden, sind bleifrei und bestehen aus hochreinen Legierungen. Sie bilden auf der Unterseite des Gehäuses eine Gitterstruktur und sorgen somit für eine bessere Nutzung der vorhandenen Fläche.

Metallurgisches Fachwissen darüber, wie Werkstoffe zur Zuverlässigkeit von elektronischen Gehäusen beitragen können, sowie eine kostengünstige Herstellungstechnik, die den höchsten Anforderungen bei den Toleranzschwellen genügt, haben die Marktposition der Umicore gestärkt.

Über die Geschäftseinheit EPM von Umicore: Die Geschäftseinheit Electronic Packaging Materials von Umicore gehört zu den marktführenden Anbietern von qualitativ hochwertigen Weichlotdrähten und -pasten für elektronische Die Attach-Anwendungen, Flussmitteln für Lotkugel- und Flipchip-Verbindungen, Materialien für Vakuum-Verbindungstechnologien sowie Amalgamkugeln für Energiesparlampen. Die Geschäftseinheit ist unter der Marke *Microbond* am Markt tätig.

<http://www.technicalmaterials.umicore.com/en/epm/>

Über Duksan: Duksan Hi-Metal Co. Ltd erwirtschaftete im Jahr 2005 einen Umsatz von 16,78 Milliarden Won und beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter. Die Gesellschaft ist an der Börse Seoul unter dem Ticker-Symbol KDQ:077360 gelistet.

Umicore AG & Co. KG Kommunikation

Rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau-Wolfgang
www.umicore.de

Telefon +49 6181 59 02
Fax +49 6181 59 4356
Email info@eu.umicore.com

Umsatzsteuer Ident-Nr. DE813 201 955
BLZ 500 107 00, Konto 560 169, SWIFT DEGU DE FF

PROFIL

Umicore ist eine Materialtechnik-Gruppe. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf folgende vier Geschäftssegmente: Edelmetall - Dienstleistungen, Edelmetall – Produkte und Katalysatoren, Neue Materialien und Zink-Spezialerzeugnisse. Jedes Geschäftssegment ist in marktorientierte Geschäftsbereiche unterteilt.

Umicore konzentriert sich auf Geschäftsbereiche, in denen sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft, Chemie und Metallurgie einen wirklichen Unterschied macht – ganz gleich ob bei Produkten des täglichen Bedarfs oder bei der Entwicklung modernster technischer Innovationen. Umicore´s oberstes Ziel ist es, nachhaltige Werte zu schaffen und Metalle zu entwickeln, herzustellen und zu recyceln, die für den Anspruch unseres Unternehmens stehen:

„Materials for a better Life“

Die Umicore-Gruppe verfügt über Produktionsbetriebe auf allen Kontinenten und beliefert Kunden weltweit. Das Unternehmen erzielte 2005 einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro und hat zurzeit etwa 14.000 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen:

Umicore AG & Co. KG:

Presse : Werner Appel – Telefon +49 6181 59 5313 – werner.appel@eu.umicore.com

Umicore AG & Co. KG Kommunikation

Rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau-Wolfgang
www.umicore.de

Telefon +49 6181 59 02
Fax +49 6181 59 4356
Email info@eu.umicore.com

Umsatzsteuer Ident-Nr. DE813 201 955
BLZ 500 107 00, Konto 560 169, SWIFT DEGU DE FF